



WB注意: 植球点在B芯

特殊说明 Special Instructions:

以随工单要求按顺序装片,如: 先装A芯片,装B芯片时必须装在

DB注意:

实物图: Chip photo:

椭圆孔

框架传送方向(装片): L/F Direction(D/A):

有A芯片的框架, 反之 先装B芯片,装A芯时B芯已经装片; HY-PX-008-409 A由HT-PX-008-066 A升级,优化胶 水为S210N,变更劈刀为SU-25100-465F-ZU34TP-Y 铝垫厚度(μm) Pad Thickness 最小焊盘间距 Min BPP(μm) 粘片胶类型 划片道宽度 减薄厚度 芯片名称 Die name 芯片尺寸 Die Size 最小焊盘尺寸 Min BPO (μm²) 焊盘下是否有电路 说明 晶圆尺寸 Epoxy type 导电胶 (conductivity) 801\*468(um²) 31.53\*18.42(mil²) A芯: DIE A HS5069 60\*60 70 是/Yes 8 否/N0 300 S210N 导电胶 1039\*682(um²) 40.90\*26.85(mil²) HS5054 68.4\*68.4 115 2.5 否/N0 60 8 否/N0 300 (conductivity) S210N DIEC 客户确认签字/盖章 制图日期 生效日期 2021/11/29 Customer Signature Create Date Effective Date 拟制 批准 Prepared by Approved by Prepared by 15-7-2021.12·3] Checked by 55-7-7-2 Approved by 15-7-7-2 Ap 页码 Page drawing mistakes, which will produce inestimable loss. Thank you 1/1